

(11)Publication number:

07-033516

(43) Date of publication of application: 03.02.1995

(51)Int.CI.

CO4B 35/20 H01B 3/12 H01F 1/10

(21)Application number: 05-155559

(71)Applicant: FINE CERAMICS CENTER

AISIN SEIKI CO LTD

NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

25.06.1993

(72)Inventor: SUGIURA HIROTANE

**FUKUI TAKEHISA** HIGASHIDA YUTAKA KADOOKA TSUTOMU

# (54) MGO-SIO2 PORCELAIN AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce an/MgO-SiO2 porecelain having excellent electric properties by obtaining the mixed sintered product of a forsterite phase and/or an enstatite phase.

CONSTITUTION: This MgO-SiO2 porcelain comprises a dense mixed sintered product having a forsterite phase and/or an enstatite phase and having an MgO/SiO2 molar ratio of 2.5/1 to 2/1.7, a dielectric constant of 6.4-7.5 and a dielectric dissipation factor of ≤1 × 10-4.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

02.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3083681

[Date of registration]

30.06.2000

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-33516

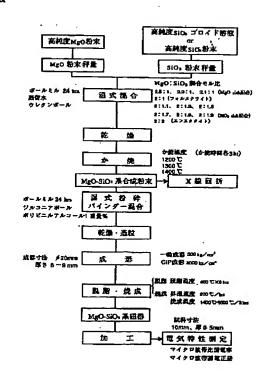
(43)公開日 平成7年(1995)2月3日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup> C 0 4 B 35/20	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01B 3/12 H01F 1/10	3 3 3	9059-5G		
-,			C 0 4 B	35/ 20
			H01F	1/ 10
			審查請求	未請求 請求項の数4 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	特願平5-155559		(71)出願人	000173522
				財団法人ファインセラミックスセンター
(22)出顧日	平成5年(1993)6	月25日		愛知県名古屋市熱田区六野2丁目4番1号
			(71)出願人	000000011
				アイシン精機株式会社
				愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
			(71)出顧人	000004547
				日本特殊陶業株式会社
				愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
			(72)発明者	杉浦 裕胤
				愛知県碧南市錦町二丁目51番地
			(74)代理人	弁理士 岡田 英彦 (外2名)
				最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 MgO-SiO2 系磁器及びその製造方法

### (57) 【要約】

【目的】フォルステライト相及び/又はエンスタタイト相との混成焼結体を得ることにより、優れた電気的性質を有するMgO-SiO2系磁器を提供すること。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】フォルステライト相及び/又はエンスタタイト相を有する緻密な混成焼結体であって、

MgOとSiO2 のモル比の範囲が2. 5対1から2対1. 7、比誘電率が6.  $4\sim7$ . 5、誘電正接が $1\times1$   $0^{-4}$ 以下であることを特徴とするMgO-SiO2 系磁器。

【請求項2】請求項1において、混成焼結体中に含まれる不純物が、A | 2 O3 O. 50%以下、CaOO. 50%以下、Fe2 O3 O. 50%以下、Na2 OO. 50%以下、ZrO2 O. 50%以下であるこ

【請求項3】(1) MgO粉末とSiO2 粉末又はSiO2 コロイド溶液とをMgOとSiO2 のモル比が2. 5対1から2対1.7の範囲で混合しか焼する工程と、

とを特徴とするMgO-SiO2系磁器。

- (2) 前記工程で得たか焼粉を平均粒径 3 μ m以下に粉砕してMgO-SiO2 系合成粉末とする工程と、
- (3) この $MgO-SiO_2$  系合成粉末を加圧成形してなる成形品を焼成してフォルステライト及び $\angle$ 又はエンスタタイト組成の $MgO-SiO_2$  系磁器とする工程、とからなることを特徴とする $MgO-SiO_2$  系磁器の製造方法。

【請求項4】請求項3において、MgO-SiO2系磁器に含まれる不純物を、AI2O3O.50%以下、CaO O.50%以下、Fe2O3O.50%以下、Na2OO.50%以下、ZrO2 O.50%以下に制御することを特徴とするMgO-SiO2系磁器の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、フォルステライト相及び/又はエンスタタイト相の混成焼結体に関し、詳しくはMgOとSiO2のモル比を2.5対1から2対1.7までの範囲で変えた高純度なMgO-SiO2系磁器及びその製造方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】従来、MgO-SiO2系磁器の代表的、なものとしては、フォルステライト(2MgO・SiO2)磁器があるが、いずれも低い誘電正接を有し、低損失誘電体材料として高周波領域の絶縁材、基板材として用いられている。このうちフォルステライト磁器に関しては、高純度な原料を用いて高純度のフォルテライト磁器を得ることにより、さらにその電気的特性を高め得ることが本発明者らにより確認されている。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ステアタイト 磁器に関しては、難焼結性で高純度で緻密な焼結体を得 ることができないため、より電気的特性を高めたステア タイト磁器を得ることが困難であった。また、ステアタ イト磁器とフォルステライト磁器は共に電気的性質に優れるものである一方、またそれぞれに特徴を持った焼結体であり、双方の電気的性質を生かしてより電気的に優れる磁器を得ることが望まれる。さらに、高純度な磁器にあっても、磁器の用途に応じて適切な電気的特性を得ることが必要である。

【0004】そこで、本発明は、フォルステライト相及び/又はエンスタタイト相との混成焼結体を得ることにより、優れた電気的性質を有するMgO-SiO2系磁器を提供することを目的とする。また、本発明は、電気的性質に優れるとともに用途に応じた適切な電気的性質を得ることができるMgO-SiO2系磁器の製造方法を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記した課題を解決するためにフォルステライト(2MgO・SiO2)組成周辺のMgO一SiO2組成の合成磁器粉末の合成条件及びこれらの合成磁器粉末成形品の焼結条件を探索した結果、焼結性を低下させることなく電気的性質に優れる緻密な焼結体を製造しうることを見いだしたのである。すなわち、前記した課題を解決するための手段として、本発明者らは、フォルステライト相及びクスはエンスタタイト相を有する緻密な混成焼結体であって、MgOとSiO2のモル比の範囲が2.5対1から2対1.7、比誘電率が6.4~7.5、誘電正接が1×10-4以下であることを特徴とするMgO一SiO2系磁器を創作した。

【0006】さらに、前記混成焼結体中に含まれる不純物が、AI2 O3 O. 50%(重量%を意味するものとする。以下同じ。)以下、CaO O. 50%以下、Fe2 O3 O. 50%以下、Na2 O O. 50%以下、ZrO2 O. 50%以下であることを特徴とするMgO-SiO2 系磁器を創作した。

【0007】また、前記した他の課題を解決するための手段として、(1) MgO粉末とSiO2 粉末又はSiO2 コロイド溶液とをMgOとSiO2 のモル比が2. 5対1から2対1. 7の範囲で混合しか焼する工程と、

- (2)前記工程で得たか焼粉を平均粒径3μm以下に粉砕してMgO-SiO2系合成粉末とする工程と、
- (3) このMgO-SiO2 系合成粉末を加圧成形してなる成形品を焼成してフォルステライト及び/又はエンスタタイト組成のMgO-SiO2 系磁器とする工程、とからなることを特徴とするMgO-SiO2 系磁器の製造方法を創作した。さらに、このMgO-SiO2系磁器の製造方法において、MgO-SiO2系磁器に含まれる不純物を、Al2O3O.50%以下、CaO
- 0.50%以下、Fe2 O3 O.50%以下、Na2 O O.50%以下、ZrO2 O.50%以下に制御することを特徴とするMgO-SiO2 系磁器の製造方法を創作した。

【〇〇〇8】前記Mg〇粉末及び前記Si〇2 粉末とは、天然に存在する原料でなく、適宜手段により不純物が排除され精製されたものをいう。ここに、不純物としてはAI、Ca、Fe、Na等が挙げられ、これらの不純物が制御されたMg〇粉末あるいはSi〇2 粉末であることが好ましい。また、前記Si〇2 コロイド溶液とは、前記不純物が制御されたコロイド溶液であることが好ましい。

【0009】前記か焼は、成形品の焼結時における焼成 収縮率を低減するとともに成分の均一化に伴う特性の安 定化のために行われる。か焼は、たとえば1200~1 400℃で2~4時間行われ、か焼後のか焼粉の組成中 にはフォルステライト相あるいはエンスタタイト相の 他、Mg O相、Si O2 相が形成される。

【0010】か焼した各組成のか焼粉の粉砕は、例えばジルコニアボールを用いたボールミルにて行うことができる。粉砕は、か焼粉の平均粒径を平均3μm以下にすることを主体として行われる。MgO-SiO2系磁器粉末の粒径が大きいと、焼結時の焼結性が悪く、緻密な焼結体を得ることができないからである。粉砕の工程においては、必要に応じてパインダとしてポリビニルアルコールやメチルセルロース等の所定量が同時に混合され、粉砕されMgO-SiO2系合成粉末とされる。なお、パインダ等の配合物も前記原料粉末等と同様に高純度のものを用いる。

【0011】前記成形品は適当な加圧成形手段により用途に応じた所定形状に成形される。成形品は、脱脂処理においてバインダ等の有機質の配合物が除去される。脱脂温度は有機質の配合物を焼失して除去しうる温度とされ、例えば300~500℃で4~7時間である。脱脂後は、続いて焼結される。焼成は、例えば、1400~1600℃で2時間で行われる。

【0012】本発明においては、原料粉末の秤量から、混合、か焼、粉砕、焼成の各工程において、混合物、か焼粉、合成粉末等に不純物が混入しないような材質や手段が用いられ、全工程を通じて常に純度について十分に配慮される。不純物は、AI2O3、CaO、Fe2O3、ZrO2を主体とする。

#### [0013]

【作用】低誘電率でしかも誘電損失の少ない緻密なMgOーSiO2系磁器であるため、信号の高速伝播が可能である。また、SiO2原料及びMgO原料からMgOーSiO2系の混合物が形成される。かかる混合物はか焼され、フォルステライト相、エンスタタイト相、SiO2相、MgO相が形成され、これら各相のうち少なくとも常に2以上の相が混在する組成のか焼粉となる。か焼され粉砕された合成粉末は、不純物が規制されていることから、高純度のMgOーSiO2系合成粉末となっており、高純度のMgOーSiO2系磁器を得ることができるものとなっている。

【 0 0 1 4 】また、M g O - S i O 2 系合成粉末の平均 粒子径を 3 μ m以下に規制すること等により焼結助剤を 不要とすることができ、焼結助剤によるガラス相の生成 を排除して緻密かつ電気的特性に優れる磁器となる。さ らに、フォルステライト組成及びそれよりも S i O 2 リ ッチな組成にあっては、S i O 2 の過剰添加による液相 生成などにより焼結温度が低下しているものと思われ る。

#### [0015]

【実施例】以下に本発明を具現化した一実施例について図1ないし図3並びに表1ないし表6に基づいて説明する。なお、本例は本発明の一例であり、本発明はこれに限定されるものではない。

【実施例 1】まず、原料として高純度MgO粉末と高純度SiO2 粉末を用意する。本例では、MgO粉末として平均粒径0.08~0.10 $\mu$ m、比表面積26.03 $m^2$  /gのものを用い、SiO2 粉末として、O.82 $\mu$ m、比表面積1.78 $m^2$  /gのものを用いた。なお、用いる原料粉末の粒度は、か焼において十分に反応する程度のものでよい。本例に用いたMgO粉末及びSiO2 粉末の純度についての分析結果は表1に示す通りである。なお、表1において、各成分の数値単位は重量%であり、一句はO.001%以下であることを示す。

[0016]

【表 1】

原料粉末		
	MgO粉末	SiOz
不純物		粉末
MgO	99.96	0.0004
S i O <sub>2</sub>	0.0020	99. 95
A 1 2 O8	0.0032	0.040
CaO	0.0035	0.007
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.0004	0.022
ZrO2	l —	
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.0002	
Na <sub>2</sub> O		0.003
ВаО		0.002
TiO2		0.002
K <sub>2</sub> O		0.004

単位:%

【 O O 1 7 】次に、図 1 にしたがって本例のM g O - S i O 2 系磁器を作製する工程を説明する。M g O と S i O 2 のモル比が 2 . 5 : 1、2 . 3 : 1、2 . 1 : 1、2 : 1、7、2 : 1、1、2 : 1、3、2 : 1、5、2 : 1、7、2 : 1、8、2 : 1、9、2 : 2(エンスタタイト組成)(計 1 1 種類)となるように前記高純度 M g O 粉末及び高純度 S i O 2 粉末を秤量し、蒸留水を加えた後、ウレタンボールを用いてボールミルで 2 4 時間混合し均一な混合物 a ~ k と

【0018】 【表2】

か焼温度		: 1200°	2	I	I:130	0°C	I	II : 140	0°C
MgO/SiO <sub>2</sub>	P1	P2	Р3	P1	P2	Р3	P1	P2	Р3
MgO rich									
a 2.5:1	F	M	S	F	M		F	M	
b 2.3:1		<b>↑</b>	Ţ		1	S		t	
c 2.1:1		1	S		M	E		M	E
d 2:1		мѕ		$ \cdot $		ЕМ↓			EM
e 2:1.1		<b>↓</b>	M		E	мs		E	
f 2:1.3	F	s			S		F	E	
g 2:1.5	s	F					E	F	
h 2:1.7	ł	1						1	
i 2:1.8									
j 2:1.9	1						1		
k 2:2	s	F	М	F	ES		Е	F	
SiO <sub>2</sub> rich									

P1:メインとなるピーク

P2:明らかに存在が認められるピーク (メインピーク

の10%以上)

P3:わずかに存在が認められるピーク

F: フォルステライト E: エンスタタイト

M: MgO S: SiO2 ↓↑:矢印の配合方向にピークが増大することを示す 【OO19】表2から明らかなように、各か焼粉Ia~ III kのMgO-SiO2の組成は、SiO2リッチな か焼粉であるか焼粉Ig~Ik及びIIIg~III k以外 のいずれのか焼粉についてもフォルステライト相を主体 としていた。また、いずれのか焼粉Ia~III kでも、 フォルステライト組成からMgOリッチになるほどMg O相が多く、SiO2リッチになるほどSiO2相ある いはエンスタタイト相が増える傾向があった。さらに、 フォルステライト組成のか焼粉Id~III dであっても フォルステライトの単一相は形成されなかった。

【0020】このようにフォルステライト単一相でないか焼粉 Ia~||| kを、ボールミルを用いて平均粒径が

 $3 \mu$  m以下になるように粉砕するとともに、バインダとしてポリビニルアルコールを1重量%加えてさらに粉砕混合し、合計24時間粉砕処理してMgO-SiO2系合成粉末1a~III kを得た。各合成粉末1a~III kの粉砕後の平均粒子径及び粒度分布をレーザ回折散乱法を用いて測定した。そのうち、平均粒子径を表3に示す。測定された平均粒子径はIII dを除きいずれも1 $\mu$  m以下であった。粒度分布の一例として、合成粉末II dの粒度分布を図2に示す。なお、この図において、右のたて目盛りは棒グラフの尺度を示し、左のたて目盛りは線グラフの尺度を示す。

【0021】 【表3】

か焼温度	I	11	111
合成粉末の種類	1200℃	1300℃	1400 ℃
a:2.5:1	0.99	0.86	
b: 2. 2:1	0.93	0.86	<del></del>
c:2.1:1	0.87	0.86	<del></del>
d:2 :1	0.84	0.91	1.46
e:2:1.1	0.87	0. 92	
f:2:1.3	0.94	0.90	<del></del>
g:2:1.5	0. 95	0.89	<del></del>
h:2:1.7	0.92	0.83	
1:2:1.8	0. 90	0.85	
j:2:1.9			
k:2:2			

単位:μm, ---:未測定

【0022】この $MgO-SiO_2$  系合成粉末  $Ia\sim I$  kを、それぞれ直径20mm、厚さ $8\sim 9mm$ の円柱形に成形した。成形は、まず  $500kg/cm^2$  の一軸成形(仮成形)し、次いで $3000kg/cm^2$  でC I P成形(本成形)して成形品とした

各成形品は加熱炉に入れ、室温から6時間で400℃とし、400℃で6時間加熱して脱脂後、続いて200℃/時間で昇温し、成形品が緻密化する焼成温度で2時間焼成した。ここにいう緻密化とは、焼成品の吸水率が0.1%以下で、気孔率が1%以下になった時をいうものとする。各焼結体の緻密化温度、両端短絡型誘電体円柱共振器法にて測定した比誘電率及び誘電正接を表4及

び図3に示す。なお、電気的測定には、前記焼成品を加工して、直径10mm、厚さ5mmの円柱形としたものを用い、測定周波数は16GHz 近辺で測定した。また、従来のフォルステライト磁器イ~ハについての比誘電率及び誘電正接を表5に示す。ここに、従来のフォルステライト磁器とは、高純度でなく、また、平均粒径が考慮されていない市販品である。なお、表5の測定値は、市販されている数社のフォルテライト磁器を直径10mm、厚さ5mmの円柱形に加工し、前記焼結体と同様の測定法で16GHz 近辺の周波数で測定したものである。

[0023]

【表4】

合成粉末の 種類	級密化温度 ℃	比誘電率 ε,	誘電正接 t a n δ ×10 <sup>-5</sup>
Ia	1600	7. 28	6.3
I b	1600	7. 17	6.2
Ιc	1550	7. 00	6.8
I d	1400	6. 89	6.6
I e	1450	6. 91	7.6
I f	1450	6. 87	8.0
Ιg	1450	6. 81	8.1
I h	1450	6. 67	7.5
I i ~ I k	焼結せず		

測定周波数: 16GHz近辺 —: 測定不可能

【0024】 【表5】

従 来 品	比誘電率 ε,	誘電正接 t a n δ ×10 <sup>-5</sup>
1	6.7	99
ㅁ	6.6	100
ハ	6.8	94

测定周波数:16GH2近辺

【002.5】表4及び図3より、合成粉末Ia~Ihを用いた焼結体は、1450℃から1600℃の範囲で緻密化することができる。すなわち、150℃範囲という広い温度範囲で緻密な焼結体が得られている。特に、合成粉末IaからIhの焼結体にあっては、1450℃で緻密化することができる。なお、合成粉末Ii~Ikについては、いずれも緻密な焼結体を得られなかった。これは、これらの合成粉末の分解溶融が生じるためと思われる。

【0026】また、合成粉末  $Ia \sim I$  hに由来する焼結体において、合成粉末  $Ia \sim II$  cの焼結体にあっては、 $6 \sim 7 \times 10^{-5}$ の誘電正接を有し、また合成粉末  $Id \sim I$  hの焼結体にあっては、 $7 \sim 8 \times 10^{-5}$ の誘電正接となっており、いずれも  $1 \times 10^{-4}$ 以下の低い誘電正接の磁器となっている。これは、従来のフォルステライト磁器の誘電正接と比較すると、ほぼ 1 オーダの低減となっている(表5参照)。

【0027】さらに、合成粉末 I a~ I hに由来する焼結体は、フォルステライト組成の合成粉末 I dの焼結体の比誘電率6.8に対して、SiO2 リッチな組成の合成粉末 I e~ I hの焼結体にあっては、6.9~6.7の比誘電率が得られ、MgOリッチの合成粉末 I a~ I

cの焼結体にあっては、7.3~7.0の比誘電率が得られている。

【0028】すなわち、合成粉末 I a~I gの焼結体にあっては、焼成温度が 1450 ℃から 1600 ℃の範囲で成形品を緻密化することができ、いずれの焼結体によっても、誘電正接を  $1\times10^{-4}$ 以下に規制することができる。特に、合成粉末 I d~I hの焼結体にあっては、 1450 ℃付近の焼成温度で緻密化し、比誘電率を 6.5 ~7.0 で、かつ誘電正接を  $7\sim8\times10^{-5}$  とすることができる。また、合成粉末 I a~I cの焼結体にあっては、 1600 ℃で焼結して緻密化すれば、誘電正接を  $6\sim7\times10^{-5}$  としつつも比誘電率を 7.5 前後まで高めることができるものとなっている。

【0029】なお、他の合成粉末IIa~IIIn, III a~III hについても I a~ I gの焼成において観察された 緻密化温度、比誘電率及び誘電正接の傾向と同様の結果 が得られている。合成粉末 I a~ I gの焼結体表面の電子顕微鏡写真をそれぞれ図4~図6に示す。図4~図6 から明らかなように、いずれの合成粉末にあっても緻密な焼結体となっている。また、フォルステライト組成からMgOリッチあるいはSiO2リッチになるほど焼結体の粒成長が抑えらえている。

【0030】さらに、得られた焼結体の×線回折の結果から、MgOとSiO2のモル比が2:1.1から2:1.7の間の組成比の焼結体にあっては、フォルステライト相とエンスタタイト相の2相のみが観察され、SiO2リッチになるほどエンスタタイト相の量が増加していた。すなわち、エンスタタイトは難焼結性で従来よりガラス相を生成させることにより緻密な焼結と転移による劣化防止を行っていたが、本実施例においては、高純度下でしかもガラス相の生成なくして緻密な焼結体とすることができた。

【0031】表6に、本実施例の焼結体における不純物 含有量の化学分析結果を示す。本実施例においては、不 純物が制御された原料を用い、工程においても不純物の 混入が制御されているために、焼結体中の不純物量はほ ぼ使用する原料中に含まれる不純物量により決まること になるし、ほぼその通りの結果が表6に示されているよ うに得られている。ただし、か焼粉の粉砕工程におい

て、ZrO2 ボールを用いているためジルコニア(Zr O2 ) については、粉砕の際の摩滅による混入量が含ま れている。

[0032]

【表6】

不純物	41.0	0.0	P. 0	V 0	7.0
焼結体の組成	A1203	Ca0	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Na₂ O	2r0 <sub>2</sub>
I a	0.017	0.005	0.014	0.001	0. 26
I h	0.024	0.005	0.010	0.002	0. 24

単位:%

【0033】 [実施例2] 次に、SiO2 原料としてS iO2 粉末でなくSiO2 コロイド溶液を用いてMgO -SiO2 磁器を製造する方法について説明する。Mg O粉末としては、実施例1と同様のものを用い、SiO 2 コロイド溶液として、溶媒が水で、SiO2 含量が、 20~21重量%、粒子径10~20nm, pH2~4 のものを用いた。このSiO2コロイド溶液の純度試験 結果を表7に示す。

[0034]

【表7】

不純物	S i O <sub>2</sub> コ ロイド溶液 中の含有量
SiO <sub>2</sub>	20~21
MgO	0.0002
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.04
CaO	0.0005
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、	0.001
Na <sub>2</sub> O	0. 02
ВаО	0.0004
TiO,	0.001
ZrO;	
B, O <sub>3</sub>	
K <sub>2</sub> O	

単位:%, ——:0.001 %以下

【0035】MgO粉末及びSiO2 コロイド溶液をM gOとSiO2のモル比が2.5:1及び2:1.7と

なるようにそれぞれ秤量、混合して混合物p及びqと し、以下、実施例1と同様の工程に従い、1200℃及 び1300℃でか焼し、か焼粉 I p 及び I q、II p 及び II qを得た。これらのか焼粉のX線回折の結果は、実施 例1における同様の組成のか焼粉に対応していた。ま た、これらのか焼粉を粉砕して得たMgO-SiO2合 成粉末の平均粒径を表8に示す。いずれも平均粒径1μ m以下であった。

[0036]

【表8】

か焼温度	I	II
粉の種類	1200℃	1300℃
p	0. 92	0.83
q	0. 90	0.85

単位: um

【0037】さらに、か焼粉 I p 及び I q を実施例 1 と 同様に成形して、同じ昇温条件で成形品が緻密化する焼 成温度で2時間焼成した。各焼結体の緻密化温度、及び 直径10mm、厚さ5mmの円柱形に加工し、実施例1 と同様の測定法による16GHz 近辺での比誘電率及び誘 電正接を表9に示す。

[0038]

【表9】

合成粉末の種類	緻密化温度 ℃	比誘電率 €,	誘電正接 tan ô ×10 <sup>-5</sup>
Ιp	1550	7.08	7.3
Ιq	1400	6.42	8.0

【0039】表9から明らかなように、SiO2 リッチな合成粉末 Iqに由来する焼結体にあっては、低い焼結温度で比誘電率の低い磁器を得られ、MgOリッチな合成粉末 Ipに由来する焼結体にあっては、誘電正接の小さい磁器を得ることができた。すなわち、SiO2 コロイド溶液をSiO2 原料として用いた場合であっても、MgOとSiO2 のモル比が 2.5:1 から 2:1.7 の範囲で実施例 1 とほぼ同様に電気的性質の優れたMg

O-SiO2 磁器を得られ、また比誘電率を7.1~6.4の範囲で変え得ることが確認できた。

【0040】また、実施例1と同様に、MgO粉末及びSiO2コロイド溶液よりなる焼結体における不純物含有量を化学分析により求めた結果を表10に示す。

[0041]

【表10】

不純物 租成	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Ca0	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Na₂ O	Zr0 <sub>2</sub>
Ιp	0.075	0.007	0.003	0.04	0. 25
Ιq	0.11	0.006	0.002	0.06	0. 22

### 単位:%

# [0042]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明のMgOーSiO2系磁器によれば、不純物が高度に制御されたMgOーSiO2系磁器であるため、低誘電損失でしかも低誘電率であり、信号の高速伝播を可能にする優れた回路基板など高周波絶縁体基板に適した材料となっている。本発明のMgOーSiO2系磁器の製造方法によれば、MgO粉末、SiO2粉末あるいはSiO2コロイド溶液を原料として用い、さらには工程において不純物の混入を制御してMgOとSiO2のモル比が2.5対1から2対1.7の範囲で混合し、か焼して平均粒径を制から2対1.7の範囲で混合し、か焼して平均粒径を制から2対1.7の範囲で混合し、か焼して平均粒径を制から2対1.7の範囲で混合し、か焼して平均粒径を制した合成粉末を得ることにより焼結性を低下させるによなく従来のフォルステライトに比べほぼ一桁以上低損失の電気的性質(誘電正接が1×10-4以下)を有の緻密な磁器を得ることができる。さらに、上記範囲の

 $MgO-SiO_2$  系磁器組成により、誘電正接(低損失性が  $1\times 10^{-4}$ 以下)を維持しつつ比誘電率を  $6.4\sim 7.5$ の範囲で調整することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のMgO一SiO2系磁器を得る工程 図。

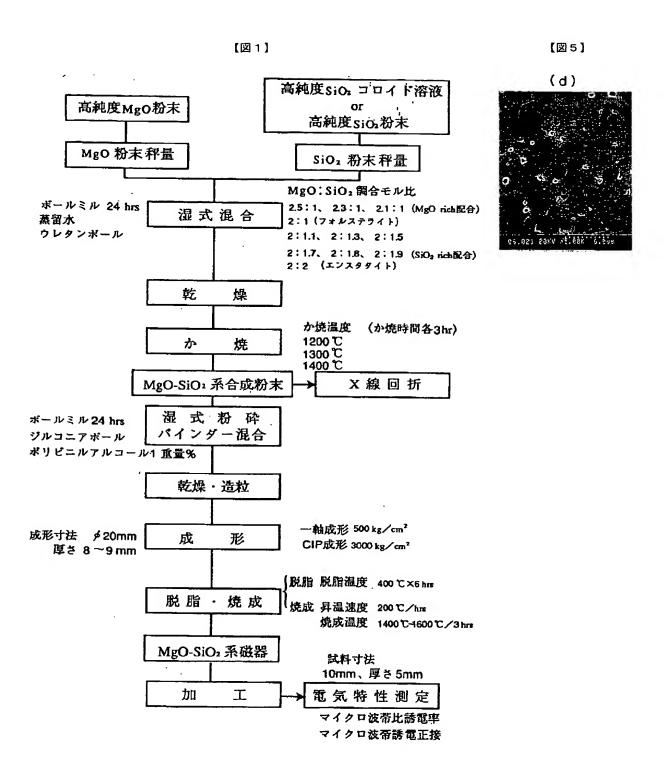
【図2】MgO-SiO2系合成粉末の粒度分布図。

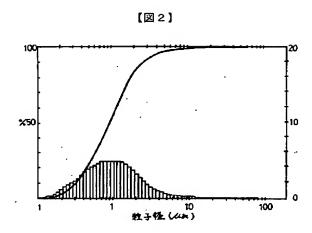
【図3】焼結体の緻密化温度、比誘電率及び誘電正接を それぞれ表す図。

【図4】合成粉末 I a ~ I c の焼結体表面の電子顕微鏡写真(a)~(c)の図。

【図5】合成粉末 I dの焼結体表面の電子顕微鏡写真(d)の図。

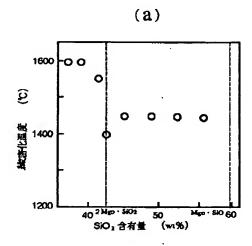
【図6】合成粉末 I e ~ I g の焼結体表面の電子顕微鏡写真(e)~(g)の図。

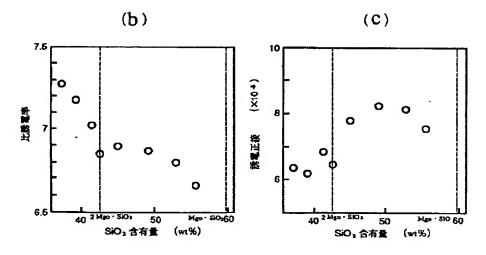


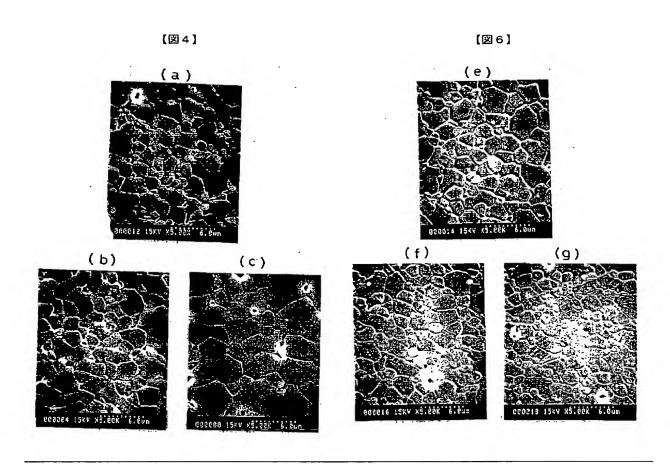




(10)







フロントページの続き

(72) 発明者 福井 武久 愛知県大府市共和町六丁目28番地の3 (72) 発明者 東田 豊

愛知県小牧市光ケ丘二丁目18番地の3

(72) 発明者 角岡 勉

愛知県刈谷市野田町段留25番地8